



# CREDIT RATING REPORT

报告名称

## 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告

目录

评定等级及主要观点

发债概况

发债主体

偿债环境

财富创造能力

偿债来源与负债平衡

外部支持

评级结论



## 信用等级公告

DGZX-R【2025】01362

大公国际资信评估有限公司通过对斯达半导体股份有限公司主体及其拟发行的斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行分析和评估，确定斯达半导体股份有限公司的主体信用等级为 AA<sup>+<sub>sti</sub></sup>，评级展望为稳定，斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的信用等级为 AA<sup>+<sub>sti</sub></sup>。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

评审委员会主任：

二〇二五年十月二十三日



## 评定等级

发债主体：**斯达半导体股份有限公司**  
 债项信用等级：**AA<sup>+</sup>**  
 主体信用等级：**AA<sup>+</sup>**  
 评级展望：**稳定**

## 债项概况

发行规模：不超过人民币 15.00 亿元（含本数）  
 债券期限：6 年  
 每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债本金并支付最后一年利息  
 偿还方式：（设置赎回条款和回售条款）  
 发行目的：用于项目建设及补充流动资金

## 主要财务数据和指标（单位：亿元、%）

项目	2025.6	2024	2023	2022
总资产	103.91	96.46	84.84	71.28
所有者权益	68.99	67.44	64.95	57.41
总有息债务	18.64	16.29	10.47	6.67
营业收入	19.36	33.91	36.63	27.05
净利润	2.79	5.13	9.21	8.21
经营性净现金流	3.64	9.63	3.83	6.68
毛利率	29.74	31.55	37.51	40.30
总资产报酬率	3.01	6.32	12.33	13.04
资产负债率	33.60	30.09	23.44	19.45
债务资本比率	21.27	19.46	13.89	10.41
EBITDA 利息保障倍数（倍）	400.66	285.23	646.06	411.85
经营性净现金流/总负债	11.40	39.37	22.68	69.92

注：公司提供了 2022~2024 年及 2025 年 1~6 月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别对公司 2022~2024 年财务报表进行了审计，并均出具了标准无保留意见的审计报告，均将“应收账款减值”和“收入确认”列为关键审计事项；公司 2025 年 1~6 月财务报表未经审计。

评级小组负责人：张行行  
 评级小组成员：房思旗  
 电话：010-67413300  
 传真：010-67413555  
 客服：4008-84-4008  
 Email: dagongratings@dagongcredit.com

## 主要观点

斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达半导”或“公司”）主要从事以 Insulated Gate Bipolar Transistor（以下简称“IGBT”）、SiC 为主的半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售业务。本次评级结果表明公司所处行业面临良好的政策环境，公司处于行业领先地位，具有很强的技术创新性和研发成果转化能力，盈利对利息保障程度很高；但公司毛利率逐年下降，存货周转效率逐年降低，可转债发行成功后或将加大债务压力。

## 优势与风险关注

### 主要优势/机遇：

- 随着全球绿色能源转型的持续推进，IGBT 作为电能转换的核心器件，面临较大的发展空间，作为国家重点支持行业，面临良好的政策环境；
- 近年来，公司产能和产量逐年增长，产销率始终保持在较高水平，拥有较强的品牌影响力和市场竞争力，处于行业领先地位；
- 公司持续加大研发投入，具有很强的技术创新性和研发成果转化能力；
- 2022~2024 年，公司盈利对利息保障程度很高。

### 主要风险/挑战：

- 2022~2024 年，公司毛利率逐年下降；
- 2022~2024 年，公司存货周转效率逐年降低，截至 2024 年末累计计提存货跌价准备同比大幅增长，仍需关注市场竞争对库存商品价值的影响及在建项目持续投入对资产流动性的影响；
- 公司可转债发行成功后，或将加大债务压力。

## 展望

预计未来，公司将继续提升技术创新能力，保持领先的行业地位。综合考虑，大公国际对未来 1~2 年斯达半导的评级展望为稳定。



## 评级模型打分表结果

本评级报告中，受评主体所依据的评级方法与模型为《科技创新企业信用评级方法与模型》，版本号为PFM-KC-2025-V. 3. 0，受评债项所依据的评级方法为《科技创新债券信用评级方法》，版本号为PF-KCZ-2025-V. 1. 0，上述方法均已在大公国际官网公开披露。本次评级主体所使用模型及结果如下表所示：

评级要素	分数
<b>要素一：财富创造能力</b>	<b>6.24</b>
（一）科技竞争力	6.39
（二）运营能力	6.16
（三）可持续发展能力	6.00
<b>要素二：偿债来源与负债平衡</b>	<b>5.54</b>
（一）偿债来源	5.24
（二）债务与资本结构	7.00
（三）保障能力分析	7.00
（四）现金流量分析	1.00
<b>调整项</b>	<b>无</b>
<b>基础信用等级</b>	<b>aa<sup>+</sup><sub>sti</sub></b>
<b>外部支持</b>	<b>0</b>
<b>模型结果</b>	<b>AA<sup>+</sup><sub>sti</sub></b>

注：大公国际对上述每个指标都设置了1~7分，其中1分代表最差情形，7分代表最佳情形。

评级模型所用的数据根据公开及公司提供资料整理。

最终评级结果由评审委员会确定，可能与上述模型结果存在差异。

## 评级历史关键信息

主体评级	债项评级	评级时间	项目组成员	评级方法和模型	评级报告
-	-	-	-	-	-



## 评级报告声明

为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：

一、本报告所载的主体信用等级仅作为斯达半导体股份有限公司发行斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券使用，未经大公国际书面同意，本报告及评级观点和评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动。

二、评级对象或其发行人与大公国际、大公国际子公司、大公国际控股股东及其控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、公正性、审慎性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。

大公国际评级人员与评级委托方、评级对象或其发行人之间，不存在影响评级客观性、独立性、公正性、审慎性的关联关系。

三、大公国际及评级项目组履行了尽职调查义务以及诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正、审慎的原则。

四、本报告的评级结论是大公国际依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意见未因评级对象或其发行人和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。

五、本报告引用的资料主要由评级对象或其发行人提供或为已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实性、准确性、完整性均由评级对象或其发行人/信息公布方负责。大公国际对该部分资料的合法性、真实性、准确性、完整性和有效性不作任何明示、暗示的陈述或担保。

由于评级对象或其发行人/信息公布方提供/公布的信息或资料存在瑕疵（如不合法、不真实、不准确、不完整及无效）而导致大公国际的评级结果或评级报告不准确或发生任何其他问题，大公国际对此不承担任何责任（无论是对评级对象或其发行人或任何第三方）。

六、本报告系大公国际基于评级对象及其他主体提供材料、介绍情况作出的预测性分析，不具有鉴证及证明功能，不构成相关决策参考及任何买入、持有或卖出等投资建议。该预测性分析受到材料真实性、完整性等影响，可能与实际经营情况、实际兑付结果不一致。大公国际对于本报告所提供信息所导致的任何直接或间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

七、本报告债项信用等级在本报告出具之日起生效，有效期为本次债券的存续期，主体信用等级有效期为 2025 年 9 月 12 日至 2026 年 9 月 11 日。在有效期限内，大公国际将根据《跟踪评级安排》对评级对象或其发行人进行定期或不定期跟踪评级，且有权根据后续跟踪评级的结论，对评级对象做出维持、变更或终止信用等级的决定并及时对外公布。

八、本报告版权属于大公国际所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。



## 发债概况

### （一）本次债券情况

本次债券是斯达半导向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，本次债券发行总额不超过人民币 150,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定，发行期限 6 年。本次债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，本次债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。本次债券每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，附带赎回条款及回售条款。

本次债券不设担保。

### （二）募集资金用途

本次债券募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

表 1 本次债券募集资金金额及计划使用情况（单位：万元）

项目名称	投资总额	拟使用募集资金
车规级 SiC MOSFET 模块制造项目	100,245.26	60,000.00
IPM 模块制造项目	30,080.35	27,000.00
车规级 GaN 模块产业化项目	30,107.68	20,000.00
补充流动资金项目	43,000.00	43,000.00
合计	203,433.29	150,000.00

数据来源：根据公司提供资料整理

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

项目基本情况介绍如下：

#### （1）车规级 SiC MOSFET 模块制造项目

本项目拟于浙江省嘉兴市南湖区新建厂房、洁净车间及相关配套基础设施，购置先进制造设备，进一步扩大公司车规级 SiC MOSFET 模块的产能。本项目拟投资 100,245.26 万元，拟使用券募集资金 60,000.00 万元，其余部分由公司自筹解决。项目建设周期为 3 年，建成后，项目内部收益率为 18.45%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 7.88 年（含建设期 3 年）。

#### （2）IPM 模块制造项目

本项目拟于重庆市高新区购买土地、新建厂房、洁净车间及相关配套基础设施，购置先进制造设备，进一步扩大公司 IPM 模块的生产规模，满足下游快速增长的市场需求，是公司对国家“双碳”战略的积极响应。本项目拟投资 30,080.35 万元，拟使用募集资金 27,000.00 万元，其余部分由公



司自筹解决。本项目建设周期为 4 年，建成后，项目内部收益率为 16.00%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 8.46 年（含建设期 4 年）。

### （3）车规级 GaN 模块产业化项目

本项目拟于上海市嘉定区购买土地、新建厂房、洁净车间及相关配套基础设施，购置先进制造设备，建设车规级 GaN 模块生产线。本项目建设共需资金 30,107.68 万元，项目建设资金拟使用募集资金 20,000.00 万元，其余部分由公司自筹解决。本项目建设周期为 4 年，建成后，项目内部收益率为 18.73%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 8.06 年（含建设期 4 年）。

## 发债主体

### （一）主体概况

公司成立于 2005 年 4 月，曾用名嘉兴斯达半导体有限公司。2011 年 10 月，经公司董事会决议通过，并经浙江省商务厅核准，公司以 2011 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，同年 11 月公司更名为嘉兴斯达半导体股份有限公司；2020 年 2 月，公司于上海证券交易所主板上市，股票代码为 603290.SH；2023 年，公司更为现名。截至 2025 年 6 月末，公司注册资本为 2.39 亿元，香港斯达控股有限公司（以下简称“香港斯达”）持有公司 41.66% 的股权，为公司的控股股东，香港斯达为 STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED 的全资子公司，美国公民沈华、胡畏夫妇通过 STARPOWER PACIFIC GROUP LIMITED 分别间接持有香港斯达 70% 和 30% 的股权，为公司的实际控制人。

### （二）公司治理结构

公司根据相关法律、法规等制订公司章程。公司设股东大会，是公司的权力机构；设董事会，对股东大会负责，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人；设董事会秘书 1 名，总经理 1 名，副总经理 5 名、财务总监 1 名，为公司高级管理人员；设监事会，由 3 名监事组成，设主席 1 人。此外，公司设立财务部、信息部、生产部、采购部等职能部门保障公司的平稳运营。此外，公司还制定了《科学技术研究开发项目管理办法》、《科学技术研究开发经费管理办法》、《专利管理制度》等制度，科研管理体系较为完善。

### （三）征信信息

根据公司提供的中国人民银行征信中心出具的企业信用报告，截至 2025 年 10 月 23 日，公司本部未结清信贷中无关注及不良信贷记录；已结清信贷中，存在关注类短期借款 22 笔，关注类银行承兑汇票 2 笔，均已于 2008~2010 年结清。截至本报告出具日，公司未在公开债券市场发行债券。

## 偿债环境

### （一）宏观环境

2025 年上半年国民经济稳中有进，政策持续发力夯实向好基础，三季度经济有望继续保持平稳增长态势。

2025 年上半年，我国经济在外部环境复杂多变、内部困难挑战交织的背景下，继续保持稳定恢复态势，总体呈现“稳中有进、结构优化、动能积聚”的特征。上半年国内生产总值同比增长 5.3%，经济运行总体平稳，其中第三产业增加值占比 59.1%，对经济增长贡献率超过 60%，继续发挥主引擎作用。消费市场稳步回升，社会消费品零售总额同比增长 5%，最终消费支出对经济增长贡献率达 52%，对经济增长的拉动作用进一步增强。投资结构持续优化，制造业投资同比增长 7.5%，高技术服务业投资同比增长 8.6%，装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长 10.2% 和 9.5%，新质生产力培



育成效显著。外贸展现较强韧性，货物进出口总额同比增长 2.9%。“新三样”继续保持较快增速，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%左右，新动能持续积累，经济高质量发展态势进一步巩固。宏观政策方面，财政政策加力提效，专项债发行进度加快，超长期特别国债等工具积极支撑基建和民生领域投资；货币政策保持适度宽松，通过降准降息、优化结构性工具等方式推动社会融资成本稳中有降。

7 月中共中央政治局会议为下半年经济工作指明方向，强调宏观政策要“持续发力、适时加力”，优化政策组合，加快政府债券发行使用，保持流动性充裕，并聚焦科技创新、内需释放、风险防范等重点任务，为实现全年经济发展目标提供坚实保障。展望三季度，随着“两重”建设加快落地、“两新”政策扩围增效，以及消费提振专项行动深入推进，内需潜力有望进一步释放，制造业投资有望保持较快增长，基础设施投资继续发挥支撑作用，服务业复苏势头预计延续。我国经济发展面临的外部环境依然复杂，但在宏观政策协同发力、市场预期逐步改善的背景下，三季度经济有望保持稳定增长态势，为实现全年 5%左右增长目标奠定坚实基础。

## （二）行业环境

随着全球绿色能源转型的持续推进，IGBT 作为电能转换的核心器件，面临较大的发展空间；IGBT 产业的技术壁垒很高，作为国家重点支持行业，面临良好的政策环境；但随着新能源汽车和光伏企业成本压降要求提高，功率半导体价格持续承压，未来仍需关注市场竞争给功率半导体行业企业带来的经营风险。

IGBT（绝缘栅双极型晶体管）是由 MOS（Metal Oxide Semiconductor，金属氧化物半导体型场效应管）和 BJT（Bipolar Junction Transistor，双极型三极管）组成的电能转换核心开关器件，属于功率半导体，是能源革命时代的“电力 CPU”，具有驱动功率小、开关速度快、饱和压降低、容量大的优点，被广泛应用于新能源汽车、光伏储能、工业控制和变频家电等领域。IGBT 产业的技术壁垒很高，相关技术从芯片设计到模块组装都需要技术积累以及在实际应用中不断调试，欧日厂商在国际市场长期占据主导地位，如德国的英飞凌、美国的安森美、日本的富士电机和三菱电机等，我国的 IGBT 产业化起步较晚，随着国内电动车、光伏、变频家电等产业的迅速发展，国产 IGBT 产业迅速发展，根据中国半导体行业协会集成电路设计分会统计数据，近十年来芯片设计企业由 2014 年的 681 家增长至 2024 年的 3,626 家<sup>1</sup>。

需求方面，随着全球绿色能源转型的持续推进，IGBT 作为电能转换的核心器件，面临较大的发展空间。首先，新能源汽车市场的迅速发展为 IGBT 带来发展机遇，根据中国汽车工业协会统计数据，2022~2024 年，新能源汽车销量分别为 688.66 万辆、949.52 万辆和 1,286.59 万辆，逐年增长，带动 IGBT 市场规模迅速扩张。根据 Technavio 发布的《Global IGBT Market 2024~2028》，2023 年中国的 IGBT 市场规模为 25.79 亿美元，在全球占比 24.8%，是该市场中最大的国家，预计 2024 年市场规模将增长至 29.55 亿美元，同时报告预测 2023~2028 年，中国对整体市场的增量贡献将达到 29.9%，到 2028 年占全球市场份额比重将提升至 27.4%。同时，电力行业绿色低碳转型持续推进，光伏发电装机规模迅速增长，2022~2024 年末，我国并网光伏（太阳能）装机分别为 3.9 亿千瓦、6.1 亿千瓦和 8.9 亿千瓦，IGBT 作为光伏逆变器的主要元器件，面临较大的市场需求。但在新能源汽

<sup>1</sup> 数据来源：中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授带来“中国芯片设计业要自强不息”主题报告演讲。



车和光伏市场蓬勃发展的同时，上游企业对成本压降提出更高要求，逐渐陷入“内卷式”恶性竞争的困境，功率半导体企业作为新能源汽车和光伏的主要供应商，价格持续承压，未来仍需关注市场竞争给功率半导体行业企业带来的经营风险。

政策方面，2022年，工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，意见指出要促进能源电子产业智能制造和运维管理，提出能源电子关键信息技术产品供给能力提升行动，其中包括发展面向光伏、风电、储能系统、半导体新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠IGBT器件模块在内的功率半导体；2024年，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3,440亿元，是国内规模最大的半导体产业投资基金，核心投资方向为半导体设备与材料光刻机、第三代半导体碳化硅（SiC）等领域；2025年8月，中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，提出要引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备等制造业重点产业链技术和产品攻关中提供中长期融资，加大对首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件和专精特新中小企业、高新技术企业、独角兽企业、重点产业链供应链企业新产品推广应用的支持力度。整体来看，功率半导体作为国家重点支持行业，面临良好的政策环境。

## 财富创造能力

公司主要从事IGBT、SiC为主的半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售业务，IGBT模块为公司收入和毛利润的主要来源，2022~2024年，公司毛利率逐年下降。

公司主要从事以IGBT、SiC为主的半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售业务。2022~2024年，公司营业收入和毛利润有所波动，毛利率逐年下降。分板块来看，IGBT模块收入和毛利润有所波动，毛利率逐年下降，其中2024年受市场竞争加剧影响，部分产品价格降幅较大，毛利率同比减少，IGBT模块为公司收入和毛利润的主要来源；其他产品主要包括SiC等产品，受IGBT单管下游的户用式光伏逆变器需求下降影响，其他产品收入逐年降低，该板块收入和毛利润占比较低。

表2 2022~2024年及2025年1~6月公司营业收入及毛利润情况（单位：亿元、%）

项目	2025年1~6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	19.36	100.00	33.91	100.00	36.63	100.00	27.05	100.00
IGBT模块	16.11	83.24	31.14	91.83	33.31	90.94	22.25	82.23
其他产品	3.24	16.76	2.77	8.17	3.32	9.06	4.81	17.77
毛利润	5.76	100.00	10.70	100.00	13.74	100.00	10.90	100.00
IGBT模块	5.01	86.97	9.87	92.29	12.57	91.46	8.82	80.90
其他产品	0.75	13.03	0.82	7.71	1.17	8.54	2.08	19.10
毛利率	29.74		31.55		37.51		40.30	
IGBT模块	31.07		31.71		37.72		39.65	
其他产品	23.12		29.78		35.35		43.31	

数据来源：根据公司提供资料整理

2025年1~6月，公司营业收入同比增长，毛利率同比减少，IGBT模块仍为收入的主要来源。



公司在 IGBT 模块市场处于行业领先地位，近年来，公司持续加大研发投入，研发人员数量和研发投入占比持续增长，拥有多项专利及科技企业称号，具有很强的技术创新性和研发成果转化能力；近年来，公司产能和产量逐年增长，产销率始终保持在较高水平，拥有较强的品牌影响力和市场竞争力。

公司长期致力于 IGBT、快恢复二极管、MOSFET 等功率芯片的设计和工艺及 IGBT、SiC MOSFET 等功率模块的设计、制造和测试，产品组合覆盖 IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT、快恢复二极管等功率半导体器件以及汽车级与工业级 MCU、栅极驱动 IC 芯片等，广泛应用于新能源、新能源汽车、工业控制与电源、白色家电、AI 服务器电源、数据中心、机器人及低空/高空飞行器等领域。2023~2024 年，公司入选《中国智能电动汽车核心零部件 100 强》中的电驱动核心零部件（功率半导体电机定转子、旋转变压器等），该板块共 7 家入选，在新能源汽车领域，公司是国内车规级 IGBT/SiC 模块的主要供应商，同时还获得了多家国外头部 Tier1 的项目定点，是国内多家主流光伏逆变器客户、风电逆变器客户的主要供应商，行业地位领先。

研发方面，公司持续增加研发投入，培养组建研发队伍。2022~2024 年，公司研发人员数量持续增长，研发投入及占营业收入比重逐年增加。此外，公司先后于瑞士苏黎世和德国纽伦堡设立海外研发中心，加大对下一代 IGBT、SiC 芯片以及模块先进封装技术的研发力度。近年来，公司先后研发出基于第七代微沟槽 Trench Field Stop 技术的新一代 1200V IGBT 芯片、Plus 版本芯片、新一代车规级 650V/750V IGBT 芯片、针对光伏应用开发的新一代 IGBT 芯片以及车规级 SiC MOSFET 芯片等核心技术，2022 年公司获得“专精特新”小巨人称号，2023 年获得高新技术企业称号，2025 年获得“专精特新”中小企业称号，截至 2025 年 6 月末，公司拥有中国境内专利共 410 项，其中：75 项发明专利、275 项实用新型、60 项外观设计，均处于专利权维持状态，具有很强的技术创新性。

表 3 2022~2024 年公司研发投入情况

项目名称	2024 年	2023 年	2022 年
研发人员数量（人）	572	483	357
占公司总人数比重（%）	23.15	24.13	25.27
费用化研发投入（亿元）	3.54	2.87	1.89
研发投入总额占营业收入比（%）	10.45	7.85	6.98

数据来源：根据公司提供资料整理

生产方面，公司产品生产环节主要分为芯片和模块设计、芯片制造、模块生产三个阶段。芯片和模块设计环节为根据客户对功率芯片关键参数的需求，设计出符合客户性能要求的芯片，或根据客户对电路拓扑及模块结构的要求，结合功率模块的电性能以及可靠性标准，设计出满足各行业性能要求的功率模块；2022~2023 年，芯片制造采取 Fabless<sup>2</sup>的模式，将完成的芯片设计方案委托给第三方晶圆代工厂进行制造，如上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海积塔半导体有限公司等外协生产商，公司不承担芯片制造环节，2024 年以来，随着募投项目的陆续结项，芯片制造开始采取“Fabless+IDM<sup>3</sup>”相结合的“Fab-lite”模式，大部分芯片以外协制造为主，一部分芯片通过全资子公司嘉兴斯达微电子有限公司自主制造；最后是模块生产环节，通过芯片贴片、回流焊接、铝线键

<sup>2</sup> Fabless 是指 Fabrication(制造)和 less(无、没有)的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”半导体公司运营模式。

<sup>3</sup> IDM 是指 Integrated Design & Manufacture，设计与制造一体的一种半导体公司运营模式。



合、测试等生产环节，最终生产出符合公司标准的功率模块。2022~2024年，公司产能及产量均逐年增长，产能利用率始终处于较高水平。

销售方面，公司销售主要采取直销方式，根据下游客户的分布情况，除嘉兴总部外在全国建立多个销售联络处，并于瑞士设立控股子公司 StarPower Europe AG，负责国际市场业务开拓和发展，销售区域涉及国内外多个国家和地区。2022~2024年，公司销量逐年增长，产销率始终保持在较高水平，销售区域以亚洲地区为主。2024年，公司前五大客户销售额合计为 11.35 亿元，占销售总额的比重为 33.47%，集中度较低，此外，公司还获得下游客户深圳市汇川技术股份有限公司颁发的“二十年战略合作奖”、阳光电源股份有限公司颁发的“2023 年度战略合作伙伴奖”等奖项，研发成果转化能力很强，拥有较强的品牌影响力和市场竞争力。

表 4 2022~2024 年公司主要产品生产和销售情况（单位：万只）

产品名称	项目	2024 年	2023 年	2022 年
IGBT 模块	产能	1,576	1,519	1,020
	产量	1,425	1,373	920
	产能利用率	90.42	90.39	90.20
	销量	1,415	1,274	980
	产销率	99.30	92.79	106.52

数据来源：根据公司提供资料整理

在建项目方面，2021 年公司通过非公开发行股票的方式募集资金，用于建设高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目等项目，承诺总投资金额为 26.77 亿元，截至 2025 年 6 月末，累计投资金额为 28.07 亿元，SiC 芯片研发及产业化项目、高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目已经顺利结项，目前处于产能爬坡阶段，预计未来随着新建产能的释放，公司的生产能力将进一步提升。

表 5 截至 2025 年 6 月末公司主要在建项目情况（单位：亿元）

项目名称	承诺投资金额	累计投资额
高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	14.77	15.33
SiC 芯片研发及产业化项目	5.00	5.58
功率半导体模块生产线自动化改造项目	7.00	7.16
合计	26.77	28.07

数据来源：根据公司提供资料整理

## 偿债来源与负债平衡

### （一）偿债来源

#### 1、盈利能力

2022~2024 年，公司持续加大研发投入，期间费用规模逐年增长。

2022~2024 年，公司期间费用和期间费用率逐年增长，以管理费用和研发费用为主，其中管理费用主要为职工薪酬和折旧摊销费等，同时，公司持续加大研发投入，研发费用逐年增长，研发投入较高；其他收益逐年增长，包括政府补助、进项税加计抵减等；信用减值损失变动不大，主要为应收账款的坏账损失；资产减值损失有所波动，其中 2024 年同比涨幅较大，主要系存货计提跌价所致。2022~2024 年，公司营业利润、利润总额及净利润均有所波动，总资产报酬率和净资产收益率逐年降低。



表 6 2022~2024 年及 2025 年 1~6 月公司盈利概况（单位：亿元、%）

项目	2025 年 1~6 月	2024 年	2023 年	2022 年
期间费用	2.84	4.82	3.36	1.89
管理费用	0.62	1.00	0.81	0.71
研发费用	2.30	3.54	2.87	1.89
期间费用/营业收入	14.65	14.23	9.19	7.00
其他收益	0.33	0.78	0.37	0.29
信用减值损失（损失以“+”列式）	-0.00 <sup>4</sup>	0.12	0.12	0.11
资产减值损失（损失以“+”列式）	0.05	0.33	0.01 <sup>5</sup>	0.01 <sup>6</sup>
营业利润	3.11	6.06	10.57	9.27
利润总额	3.11	6.06	10.44	9.27
净利润	2.79	5.13	9.21	8.21
总资产报酬率	3.01	6.32	12.33	13.04
净资产收益率	4.05	7.61	14.18	14.30

数据来源：根据公司提供资料整理

2025 年 1~6 月，公司期间费用及期间费用率同比增长，主要系公司人员增加，管理运营成本增加以及持续加大研发投入所致；其他收益同比减少；资产减值损失同比大幅增长，主要系计提的存货跌价同比增长所致；公司营业利润和利润总额同比减少，净利润同比增长。

## 2、筹资能力及资产可变现性

作为 A 股上市公司，公司可通过定向增发等方式进行股权融资，辅以银行借款进行间接融资。

作为 A 股上市公司，公司可通过定向增发等方式进行股权融资，截至 2025 年 6 月末，经过定向增发、创投融资和资本公积转增股本，公司总股本为 2.39 亿元。此外，公司还通过银行借款进行间接融资，截至 2025 年 6 月末，公司获得银行授信额度为 28.05 亿元，尚未使用额度为 9.56 亿元。

2022~2024 年末，公司总资产规模逐年增长，资产受限比例很低；但公司存货周转效率逐年降低，截至 2024 年末累计计提存货跌价准备同比大幅增长，仍需关注市场竞争对库存商品价值的影响；此外还需关注在建项目持续投入对资产流动性的影响。

2022~2024 年末，公司总资产规模逐年增长，逐渐由以流动资产为主转为以非流动资产为主。2025 年 6 月末，公司总资产规模较 2024 年末有所增长，仍以非流动资产为主。

公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等构成。2022~2024 年末，公司货币资金逐年减少，截至 2024 年末，受限货币资金为 0.44 亿元，受限比例较低；应收账款逐年增长，截至 2024 年末，账龄主要集中在 1 年以内，累计计提坏账准备 0.50 亿元，期末前五大欠款方合计占比 44.07%，集中度一般；存货规模逐年增长，主要为原材料和库存商品，截至 2024 年末，累计计提存货跌价准备 0.35 亿元，同比大幅增长，仍需关注市场竞争对库存商品价值的影响。2025 年 6 月末，公司流动资产较 2024 年末略有增长，各主要科目变动不大。

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和其他非流动资产等构成。2022~2024 年末，公司固定资产规模逐年增长，其中 2023 年末同比增幅较大，主要系再融资募投项目持续投入所致，2024 年末继续大幅增长，主要系生产、研发设备增加购置所致；随着对在建项目的持续投入，在建

<sup>4</sup> 金额为-195,032.02 元。

<sup>5</sup> 金额为 572,231.56 元。

<sup>6</sup> 金额为 575,477.29 元。



工程逐年增长，需关注在建项目持续投入对资产流动性的影响；其他非流动资产有所波动，主要为预付的设备工程款。2025年6月末，公司非流动资产较2024年末有所增长，随着在建项目转固，固定资产较2024年末有所增长，在建工程有所减少。

表7 2022~2024年末及2025年6月末公司资产构成（单位：亿元、%）

项目	2025年6月末		2024年末		2023年末		2022年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	11.89	11.45	11.90	12.34	19.11	22.53	28.68	40.24
应收账款	9.26	8.91	9.13	9.46	6.91	8.14	5.41	7.59
存货	15.74	15.15	12.80	13.27	12.61	14.86	7.02	9.85
<b>流动资产合计</b>	<b>41.12</b>	<b>39.57</b>	<b>38.33</b>	<b>39.74</b>	<b>43.66</b>	<b>51.47</b>	<b>51.59</b>	<b>72.38</b>
固定资产	39.98	38.47	25.01	25.93	15.06	17.75	6.68	9.37
在建工程	18.85	18.14	30.59	31.72	16.68	19.66	9.58	13.44
其他非流动资产	1.82	1.75	1.13	1.17	8.16	9.62	2.50	3.51
<b>非流动资产合计</b>	<b>62.79</b>	<b>60.43</b>	<b>58.13</b>	<b>60.26</b>	<b>41.17</b>	<b>48.53</b>	<b>19.69</b>	<b>27.62</b>
<b>资产合计</b>	<b>103.91</b>	<b>100.00</b>	<b>96.46</b>	<b>100.00</b>	<b>84.84</b>	<b>100.00</b>	<b>71.28</b>	<b>100.00</b>

数据来源：根据公司提供资料整理

资产运营效率方面，2022~2024年末，公司应收账款周转天数分别为58.62天、60.54天和85.13天，存货周转天数分别为122.38天、154.31天和197.06天，运营效率均逐年下降；2025年1~6月，公司应收账款周转天数和存货周转天数分别为85.50天和188.89天。

受限资产方面，截至2024年末，公司受限资产规模为0.44亿元，占总资产和净资产的比重分别为0.45%和0.65%；截至2025年6月末，公司受限资产规模为0.26亿元，占总资产和净资产比重分别为0.25%和0.38%，受限比例很低。

## （二）债务及资本结构

2022年末以来，公司负债规模和资产负债率持续增长，总有息债务规模持续增长，占总负债比重一般，负债水平低；但公司筹划发行的可转债发行成功后，或将加大债务压力。

2022年末以来，公司负债规模和资产负债率持续增长，以非流动负债为主，负债水平低。

公司流动负债主要由应付账款和合同负债等构成。2022~2024年末，公司应付账款逐年增长，主要为应付的设备和原材料采购款；合同负债有所波动，其中2024年末同比涨幅较大，主要系当期预收的货款增长所致。2025年6月末，公司流动负债较2024年末有所增长，其中应付账款较2024年末有所增长，其他各主要科目变动不大。

公司非流动负债主要由长期借款和递延收益等构成。2022~2024年末，公司长期借款逐年增长，主要为保证借款；递延收益逐年增长，主要为收到的尚未满足结转条件的政府补助。2025年6月末，公司非流动负债较2024年末有所增长，长期借款及递延收益较2024年末均有所增长。

有息债务方面，2022~2024年末，公司总有息债务规模逐年增长，占总负债比重一般，以长期有息债务为主。截至2025年6月末，公司总有息债务继续增长，期末现金及现金等价物余额对短期有息债务的保障倍数为57.25倍。此外，公司筹划发行的可转债发行成功后，预计有息债务将大幅增长，或将加大债务压力。

截至2025年6月末，公司无对外担保及重大未决诉讼。



表 8 2022~2024 年末及 2025 年 6 月末公司负债情况 (单位: 亿元、%)

项目	2025 年 6 月末		2024 年末		2023 年末		2022 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	10.18	29.15	7.98	27.50	5.68	28.54	4.79	34.55
合同负债	0.44	1.25	0.62	2.13	0.17	0.85	0.28	2.00
流动负债合计	12.40	35.51	10.01	34.49	6.91	34.77	5.79	41.76
长期借款	18.38	52.64	16.07	55.37	10.42	52.40	6.64	47.86
递延收益	3.36	9.64	2.30	7.94	2.20	11.08	1.43	10.33
非流动负债合计	22.52	64.49	19.01	65.51	12.97	65.23	8.08	58.24
负债总额	34.92	100.00	29.02	100.00	19.89	100.00	13.87	100.00
短期有息债务	0.20	0.58	0.19	0.65	0.05	0.25	0.04	0.27
长期有息债务	18.44	52.80	16.10	55.48	10.42	52.41	6.64	47.86
总有息债务 <sup>7</sup>	18.64	53.38	16.29	56.13	10.47	52.66	6.67	48.13
资产负债率		33.60		30.09		23.44		19.45

数据来源: 根据公司提供资料整理

2022~2024 年末, 公司所有者权益规模逐年增长, 其中资本公积和未分配利润合计占所有者权益比重较高。

2022~2024 年末, 公司所有者权益规模逐年增长, 其中资本公积和未分配利润合计占所有者权益比重较高。2024 年末, 公司股本规模同比增长, 主要系 2024 年 4 月, 公司进行利润分配及转增股本, 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股, 转增 68,392,256 股, 新增股本 68,392,256.00 元, 2024 年 6 月, 公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已达成, 发行新股新增股本 121,484.00 元; 资本公积略有波动; 随着利润累积, 未分配利润逐年增长, 2022~2024 年, 公司计提分配普通股股利 1.20 亿元、2.45 亿元和 2.73 亿元; 少数股东权益逐年增长, 其中 2023 年末同比涨幅较大, 主要系当期与深蓝汽车科技有限公司成立合资公司重庆安达半导体有限公司, 少数股东权益规模占所有者权益比重较低。2025 年 6 月末, 公司所有者权益规模较 2024 年末变动不大, 少数股东权益较 2024 年末有所增长, 其他各主要科目变动不大。

表 9 2022~2024 年末及 2025 年 6 月末公司所有者权益构成表 (单位: 亿元、%)

项目	2025 年 6 月末		2024 年末		2023 年末		2022 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股本	2.39	3.47	2.39	3.55	1.71	2.63	1.71	2.97
资本公积	39.64	57.46	39.64	58.78	40.19	61.89	39.89	69.48
未分配利润	25.02	36.26	23.78	35.27	21.58	33.23	14.93	26.01
少数股东权益	0.91	1.31	0.62	0.92	0.59	0.91	0.03	0.06
所有者权益合计	68.99	100.00	67.44	100.00	64.95	100.00	57.41	100.00

数据来源: 根据公司提供资料整理

2022~2024 年, 公司盈利对利息保障程度很高, 流动资产和速动资产均可对流动负债形成覆盖, 债务负担低。

2022~2024 年, 公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 411.85 倍、646.06 倍和 285.23 倍, 盈利对利息的保障程度有所波动, 但仍处于保障程度很高的水平; 总有息债务/EBITDA 分别为 0.67 倍、0.91

<sup>7</sup> 公司未提供截至 2025 年 6 月末的有息债务期限结构。



倍和 1.97 倍，盈利对有息债务的保障程度逐年下降。

公司融资渠道通畅，对公司的偿债来源形成一定支持。2022~2024 年末，公司流动比率分别为 8.91 倍、6.31 倍和 3.83 倍，速动比率分别为 7.70 倍、4.49 倍和 2.55 倍，流动资产和速动资产均可对流动负债形成覆盖；债务资本比率分别为 10.41%、13.89%和 19.46%，债务负担低。

### （三）现金流

2022~2024 年，公司经营性现金流持续净流入，经营性净现金流对利息的覆盖程度很高；投资性现金流持续净流出；筹资性现金流持续净流入。

2022~2024 年，公司经营性现金流持续净流入，净流入规模有所波动，主要受购买商品、接受劳务支付的现金的变动影响，现金回笼率分别为 95.23%、92.23%和 84.27%，现金回笼水平逐年下降且有待增强，但经营性净现金流对利息的覆盖程度很高；随着对募投项目的资金投入及购买理财产品，投资性现金流持续净流出；筹资性现金流持续净流入，净流入规模有所波动，其中 2023 年同比减少，主要系取得借款减少加之分配现金股利增长所致。

表 10 2022~2024 年及 2025 年 1~6 月公司现金流及偿债指标情况（单位：亿元）

项目	2025 年 1~6 月	2024 年	2023 年	2022 年
经营性净现金流	3.64	9.63	3.83	6.68
投资性净现金流	-4.74	-19.68	-15.11	-12.25
筹资性净现金流	1.11	2.50	1.70	4.52
经营性净现金流利息保障倍数（倍）	292.30	331.59	214.07	277.80
经营性净现金流/流动负债（%）	32.52	113.76	60.24	151.41
经营性净现金流/总负债（%）	11.40	39.37	22.68	69.92

数据来源：根据公司提供资料整理

2025 年 1~6 月，公司经营性现金流同比维持净流入，净流入规模同比减少，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资性现金流同比维持净流出，净流出规模同比减少，主要系收回投资且本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资性现金流同比维持净流入，净流入规模同比减少，主要系公司偿还债务支付的现金增加所致。

### 外部支持

作为高新技术企业，公司可享受政府补助和税收优惠政策等外部支持。

公司在政府补助等方面能够得到政府支持，2022~2024 年，公司收到计入其他收益的政府补助分别为 0.29 亿元、0.34 亿元和 0.31 亿元，对利润的贡献较小。此外，作为高新技术企业，公司可享受税收优惠政策，公司于 2023 年 12 月 8 日取得高新技术企业证书（证书编号为：GR202333013056），认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2023 年至 2025 年），所得税税率减按 15%征收。

### 评级结论

综合分析，大公国际评定斯达半导信用等级为 AA<sup>+</sup><sub>st1</sub>，评级展望为稳定。评定本次债券信用等级为 AA<sup>+</sup><sub>st1</sub>。



## 跟踪评级安排

在本信用评级报告所载信用等级有效期内,大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)将持续关注评级对象外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及评级对象履行债务的情况。

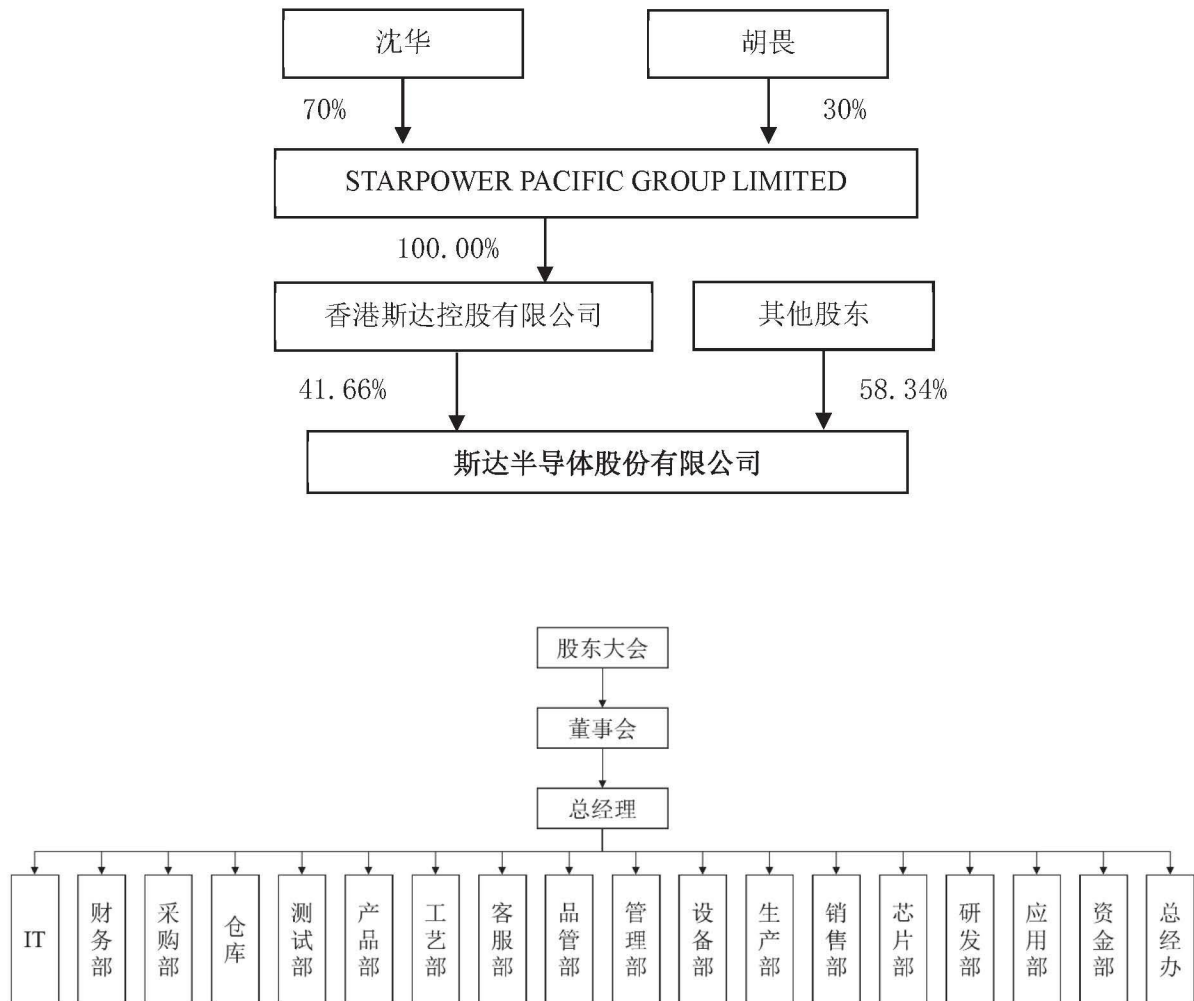
大公国际将在债券上市挂牌期间,在每年发债主体发布年度报告后 3 个月内,且不晚于每一会计年度结束之日起 7 个月出具一次定期跟踪评级报告;对于一年期内的受评证券,大公国际将于债券正式发行后的第 7 个月出具定期跟踪评级报告,另有规定的除外。此外,大公国际将在发生可能影响评级对象信用质量的重大事项后,启动不定期跟踪评级程序,并在评级分析结束后,将跟踪评级报告和评级结果向评级对象、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

如评级对象不能及时提供跟踪评级所需资料,大公国际可采取公告延迟披露跟踪评级报告,或根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布评级报告所公布的信用等级暂时失效、终止评级等评级行动。



## 附件 1 公司治理

1-1 截至 2025 年 6 月末斯达半导体股份有限公司股权结构及组织结构图



资料来源：根据公司提供资料整理



## 1-2 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券基本条款

债券品种	可转换公司债券
债券名称	斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行规模	不超过人民币150,000.00万元（含本数）
债券期限	自发行之日起六年
债券利率	<p>本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。</p>
还本付息的期限和方式	<p>本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。</p> <p>（1）年利息计算</p> <p>年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。</p> <p>年利息的计算公式为：<math>I=B \times i</math></p> <p>I：指年利息额；</p> <p>B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；</p> <p>i：指本次可转换公司债券当年票面利率。</p> <p>（2）付息方式</p> <p>1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。</p> <p>2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。</p> <p>3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。</p> <p>4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。</p> <p>5）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。</p>
转股期限	<p>本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。</p>



## 1-2 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券基本条款（续）

转股价格的确定及调整	<p>(1) 初始转股价格的确定依据</p> <p>本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。</p> <p>若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。</p> <p>前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。</p> <p>(2) 转股价格的调整方式及计算公式</p> <p>在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：</p> <p>派送股票股利或转增股本：<math>P1=P0/(1+n)</math></p> <p>增发新股或配股：<math>P1=(P0+A\times k)/(1+k)</math></p> <p>上述两项同时进行：<math>P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)</math></p> <p>派送现金股利：<math>P1=P0-D</math></p> <p>上述三项同时进行：<math>P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)</math></p> <p>其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。</p> <p>当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。</p> <p>当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。</p>
------------	---



## 1-2 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券基本条款（续）

转股价格向下修正条款	<p>(1) 修正条件及修正幅度</p> <p>在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。</p> <p>上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。</p> <p>(2) 修正程序</p> <p>如公司决定向下修正转股价格，公司将上海证券交易网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。</p>
转股股数的确定方式	<p>本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：<math>Q=V/P</math>，并以去尾法取一股的整数倍。</p> <p>其中：Q指转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。</p>
赎回条款	<p>(1) 到期赎回条款</p> <p>在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。</p> <p>(2) 有条件赎回条款</p> <p>在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转换公司债券：</p> <p>1) 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；</p> <p>2) 当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。</p> <p>当期应计利息的计算公式为：<math>I_A=B \times i \times t/365</math></p> <p><math>I_A</math>：指当期应计利息；</p> <p><math>B</math>：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；</p> <p><math>i</math>：指本次可转债当年票面利率；</p> <p><math>t</math>：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。</p> <p>本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。</p> <p>若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。</p>



## 1-2 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券基本条款（续）

回售条款	<p>（1）有条件回售条款</p> <p>在本次可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。</p> <p>若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。</p> <p>当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。</p> <p>本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。</p> <p>（2）附加回售条款</p> <p>若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。</p> <p>当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。</p>
转股年度有关股利的归属	<p>因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。</p>
发行方式及发行对象	<p>本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。</p>
向原股东配售的安排	<p>本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。</p> <p>公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。</p>
担保事项	<p>公司本次发行的可转债未提供担保措施</p>



## 附件 2 斯达半导体股份有限公司主要财务指标

(单位: 亿元)

项目	2025年1~6月 (未经审计)	2024年	2023年	2022年
货币资金	11.89	11.90	19.11	28.68
存货	15.74	12.80	12.61	7.02
固定资产	39.98	25.01	15.06	6.68
在建工程	18.85	30.59	16.68	9.58
<b>总资产</b>	<b>103.91</b>	<b>96.46</b>	<b>84.84</b>	<b>71.28</b>
应付账款	10.18	7.98	5.68	4.79
长期借款	18.38	16.07	10.42	6.64
短期有息债务	0.20	0.19	0.05	0.04
<b>总有息债务</b>	<b>18.64</b>	<b>16.29</b>	<b>10.47</b>	<b>6.67</b>
<b>总负债</b>	<b>34.92</b>	<b>29.02</b>	<b>19.89</b>	<b>13.87</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>68.99</b>	<b>67.44</b>	<b>64.95</b>	<b>57.41</b>
营业收入	19.36	33.91	36.63	27.05
净利润	2.79	5.13	9.21	8.21
经营性净现金流	3.64	9.63	3.83	6.68
投资性净现金流	-4.74	-19.68	-15.11	-12.25
筹资性净现金流	1.11	2.50	1.70	4.52
毛利率(%)	29.74	31.55	37.51	40.30
营业利润率(%)	16.07	17.88	28.85	34.28
总资产报酬率(%)	3.01	6.32	12.33	13.04
净资产收益率(%)	4.05	7.61	14.18	14.30
资产负债率(%)	33.60	30.09	23.44	19.45
债务资本比率(%)	21.27	19.46	13.89	10.41
流动比率(倍)	3.32	3.83	6.31	8.91
速动比率(倍)	2.05	2.55	4.49	7.70
存货周转天数(天)	188.89	197.06	154.31	122.38
应收账款周转天数(天)	85.50	85.13	60.54	58.62
经营性净现金流/流动负债(%)	32.52	113.76	60.24	151.41
经营性净现金流/总负债(%)	11.40	39.37	22.68	69.92
经营性净现金流利息保障倍数(倍)	292.30	331.59	214.07	277.80
EBIT 利息保障倍数(倍)	250.55	209.88	585.00	386.36
EBITDA 利息保障倍数(倍)	400.66	285.23	646.06	411.85
现金回笼率(%)	87.11	84.27	92.23	95.23
担保比率(%)	0	0	0	0



## 附件 3 主要指标的计算公式

指标名称	计算公式
毛利率 (%)	$(1 - \text{营业成本} / \text{营业收入}) \times 100\%$
EBIT	利润总额 + 计入财务费用的利息支出
EBITDA	EBIT + 折旧 + 摊销
EBITDA 利润率 (%)	EBITDA / 营业收入 $\times 100\%$
总资产报酬率 (%)	EBIT / 年末资产总额 $\times 100\%$
净资产收益率 (%)	净利润 / 年末净资产 $\times 100\%$
现金回笼率 (%)	销售商品及提供劳务收到的现金 / 营业收入 $\times 100\%$
资产负债率 (%)	负债总额 / 资产总额 $\times 100\%$
债务资本比率 (%)	总有息债务 / (总有息债务 + 所有者权益) $\times 100\%$
总有息债务	短期有息债务 + 长期有息债务
短期有息债务	短期借款 + 应付票据 + 其他流动负债 (应付短期债券) + 一年内到期的非流动负债 + 其他应付款 (付息项) + 其他短期有息债务
长期有息债务	长期借款 + 应付债券 + 长期应付款 (付息项) + 其他长期有息债务
担保比率 (%)	担保余额 / 所有者权益 $\times 100\%$
经营性净现金流 / 流动负债 (%)	经营性现金流量净额 / [(期初流动负债 + 期末流动负债) / 2] $\times 100\%$
经营性净现金流 / 总负债 (%)	经营性现金流量净额 / [(期初负债总额 + 期末负债总额) / 2] $\times 100\%$
存货周转天数 <sup>8</sup>	360 / (营业成本 / 年初末平均存货)
应收账款周转天数 <sup>9</sup>	360 / (营业收入 / 年初末平均应收账款)
流动比率	流动资产 / 流动负债
速动比率	(流动资产 - 存货) / 流动负债
现金比率 (%)	(货币资金 + 交易性金融资产) / 流动负债 $\times 100\%$
扣非净利润	净利润 - 公允价值变动收益 - 投资收益 - 汇兑收益 - 资产处置收益 - 其他收益 - (营业外收入 - 营业外支出)
可变现资产	总资产 - 在建工程 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产
EBIT 利息保障倍数 (倍)	EBIT / (计入财务费用的利息支出 + 资本化利息)
EBITDA 利息保障倍数 (倍)	EBITDA / (计入财务费用的利息支出 + 资本化利息)
经营性净现金流利息保障倍数 (倍)	经营性现金流量净额 / (计入财务费用的利息支出 + 资本化利息)

<sup>8</sup> 半年度取 180 天。<sup>9</sup> 半年度取 180 天。



## 附件 4 信用等级符号和定义

### 4-1 科技创新企业信用等级符号及定义

信用等级	定义	
AAA <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	
AA <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。	
A <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。	
BBB <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。	
BB <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。	
B <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。	
CCC <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。	
CC <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。	
C <sub>sti</sub>	受评主体具有科技创新属性，不能偿还债务。	
展望	正面	存在有利因素，一般情况下，信用等级上调的可能性较大。
	稳定	信用状况稳定，一般情况下，信用等级调整的可能性不大。
	负面	存在不利因素，一般情况下，信用等级下调的可能性较大。

注：除 AAA<sub>sti</sub> 级、CCC<sub>sti</sub> 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

### 4-2 中长期科技创新债券信用等级符号及定义

信用等级	定义
AAA <sub>sti</sub>	科技创新债券的偿还能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
AA <sub>sti</sub>	科技创新债券的偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
A <sub>sti</sub>	科技创新债券的偿还能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
BBB <sub>sti</sub>	科技创新债券的偿还能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。
BB <sub>sti</sub>	科技创新债券的偿还能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。
B <sub>sti</sub>	科技创新债券的偿还能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。
CCC <sub>sti</sub>	科技创新债券的偿还能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。
CC <sub>sti</sub>	在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还科技创新债券。
C <sub>sti</sub>	不能偿还科技创新债券。

注：除 AAA<sub>sti</sub> 级、CCC<sub>sti</sub> 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。



# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101051000158757



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 大公国际资信评估有限公司

类型 有限责任公司(国有控股)

法定代表人 吕柏乐

经营范围

企业信用度及有价证券等级评估；向国内外申请贷款及担保信用度评估；项目可行性研究及可行性研究报告编制与评估；证券市场资信评级业务；互联网信息服务；股份制改组企业方案设计、财务咨询服务；信用管理咨询服务；企业管理咨询服务及人员培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资  
成 立 日 期  
1994年03月10日

住 所 北京市西城区三里河二区甲18号01-04



2025年05月28日

登记机关



### 大公国际资信评估有限公司等两家公司完成信用评级机构备案

字号 大 中 小

文章来源: 营业管理部

2020-07-03 15:26:13

[打印本页](#) [关闭窗口](#)

按照2019年11月26日人民银行、发展改革委、财政部、证监会联合发布的《信用评级业管理暂行办法》规定,中国人民银行营业管理部对该办法实施前已经开展信用评级业务的大公国际资信评估有限公司(统一社会信用代码:911101051000158757,全球法人机构识别编码:300300T519PT4DW40896)、北京中北联信用评级有限公司(统一社会信用代码:91110108MA001WX506,全球法人机构识别编码:300300MOAZG0T626786)完成备案办理。

提示:完成备案办理不视为对信用评级机构评级质量、技术方法、风险管理、内控合规等方面的认可和保证。

中国人民银行营业管理部

2020年7月3日

[打印本页](#) [关闭窗口](#)



[法律声明](#) | [联系我们](#) | [设为首页](#) | [加入收藏](#)

京ICP备05073439号 网站标识码:bm25000001 京公网安备 11010202000016号

网站主办单位:中国人民银行办公厅 最佳分辨率:1024\*768



# 中国保险监督管理委员会

China Insurance Regulatory Commission

为科

首页 保监会简介 发布与解读 工作动态 政策法规 行政许可 行政处罚 统计数据 派出机构 消费者保护

您现在的位置：首页 > 工作动态 > 公告通知 > 公告

## 关于认可7家信用评级机构能力备案的公告

发布时间：2013-10-17

分享到：

【字体：大 中 小】

保监公告〔2013〕11号

根据《中国保监会关于加强保险资金投资债券使用外部信用评级监管的通知》（保监发〔2013〕61号）的规定，中国保监会对下列7家信用评级机构能力认可的备案材料进行了评估，现予以公告。

具体名单如下（按公司名称字母顺序排列）：

- 大公国际资信评估有限公司
- 东方金诚国际信用评估有限公司
- 联合信用评级有限公司
- 联合资信评估有限公司
- 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
- 中诚信国际信用评级有限责任公司
- 中诚信证券评估有限公司

上述信用评级机构承诺接受中国保监会的持续监管及行业协会的自律管理，配合中国保监会对相关信用评级业务的询问和检查，依规履行报告义务。

中国保险监督管理委员会

二〇一三年十月九日



首页  
HOME

政务

信息公开 政策法规 新闻发布  
信息披露 统计数据 人事招聘

服务

办事指南在线申报监管对象  
业务资格人员资格投资者保护

互动

公众留言 信访专栏 举报专栏  
在线访谈 征求意见 廉政评议



您的位置: 首页 > 公司债券监管部 > 资信评级机构备案

### 完成首次备案的证券评级机构名录

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-10-21 来源:

完成首次备案的证券评级机构名录 (按照系统报送时间排序)

序号	资信评级机构名称	备案类型	机构注册地	备案公示时间
1	东方金诚国际信用评估有限公司	首次备案	北京市	2020-10-21
2	浙江大普信用评级股份有限公司	首次备案	浙江省	2020-10-21
3	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	首次备案	上海市	2020-10-21
4	标普信用评级(中国)有限公司	首次备案	北京市	2020-10-21
5	联合资信评估股份有限公司	首次备案	北京市	2020-10-21
6	中证鹏元资信评估股份有限公司	首次备案	深圳市	2020-10-21
7	大公国际资信评估有限公司	首次备案	北京市	2020-10-21
8	安融信用评级有限公司	首次备案	北京市	2020-10-21
9	中诚信国际信用评级有限责任公司	首次备案	北京市	2020-10-21
10	远东资信评估有限公司	首次备案	上海市	2020-11-30
11	北京中北联信用评估有限公司	首次备案	北京市	2020-11-30

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号



中国证券业协会  
Securities Association of China

自律 服务 传导  
self-regulation service communication

登记基本信息

姓名	房思旗	性别	女	
执业机构	大公国际资信评估有限公司	登记编号	R0020220010008	
执业岗位	证券投资咨询(其他)	学历	硕士研究生	
登记日期	2020-01-07			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
R0020220010008	2020-01-07	大公国际资信评估有限公司	证券投资咨询(其他)	正常	



中国证券业协会  
Securities Association of China

自律 服务 传导  
self-regulation service communication

登记基本信息

姓名	房思旗	性别	女	
执业机构	大公国际资信评估有限公司	登记编号	R0020123100039	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2023-10-27			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
R0020123100039	2023-10-27	大公国际资信评估有限公司	一般证券业务	正常	